market@aporesearch.com | +86-17600652182
全球市场研究报告出版机构



2026–2032年中国扇出型晶圆级封装市场展望报告

行业	发布日期	页数	格式
电子与半导体	2025-12-27	84	PDF

报告编号	出版方	更新日期
1740096703	APO Research Inc.	2026-07-20

报告版本与报价

中文报告	PDF ¥22,900	PDF + Word ¥26,900	PDF + Excel ¥25,400	PDF + Word + Excel ¥27,900
英文报告	PDF ¥22,900	PDF + Word ¥26,900	PDF + Excel ¥25,400	PDF + Word + Excel ¥27,900
中英文报告	PDF ¥45,800	PDF + Word ¥49,800	PDF + Excel ¥48,300	PDF + Word + Excel ¥50,800

APO RESEARCH
报告样本 · 仅供评估 · 1740096703

报告简介

根据 APO Research（河南阿谱尔国际信息咨询有限公司）的统计及预测，2026年中国扇出型晶圆级封装市场销售收入为 百万元，预计到2032年将达 百万元，2026-2032年间年复合增长率(CAGR)为 %。

本报告旨在全面梳理扇出型晶圆级封装市场，深入洞悉行业特点、市场存量空间及增量空间，并结合市场发展前景评估扇出型晶圆级封装领域内各类竞争者所处地位。

竞争格局来看，在中国市场，扇出型晶圆级封装的主要生产企业包括主要包括台积电、日月光半导体、江苏长电科技、艾克尔科技和矽品科技等，其中 占据的市场份额最大，其次是 ，预计2026年前五大厂商份额为 %。

从产品类型方面来看，高密度扇出型封装占有重要地位，预计2032年份额将达到 %。同时就应用来看，CMOS图像传感器在2026年份额大约是 %，未来几年CAGR大约为 %。

本报告覆盖中国市场中扮演重要角色的全球及本土公司收入、毛利率等关键指标。历史数据为2021–2025年，预测数据为2026–2032年

主要企业包括：

台积电

日月光半导体

江苏长电科技

艾克尔科技

矽品科技

Nepes

按照不同产品类型，包括如下几个类别：

高密度扇出型封装

核心扇出型封装

按照不同应用，主要包括如下几个方面：

CMOS图像传感器

(c) 2026 APO Research. 版权所有。

无线连接

逻辑与存储集成电路

微机电系统和传感器

模拟和混合集成电路

其他应用

本文正文共8章，各章节主要内容如下：

第1章：

报告统计范围、产品细分及中国总体规模及增长率，2021-2032年

第2章：

中国市场扇出型晶圆级封装主要企业竞争分析，主要包括扇出型晶圆级封装收入、市场份额、及行业集中度等

第3章：

中国市场扇出型晶圆级封装主要企业基本情况介绍，包括公司简介、扇出型晶圆级封装产品、扇出型晶圆级封装收入及最新动态等

第4章：

中国不同产品类型扇出型晶圆级封装规模及份额等

第5章：

中国不同应用扇出型晶圆级封装规模及份额等

第6章：

行业发展环境分析

第7章：

行业供应链分析

第8章：

报告结论

APO RESEARCH
报告样本 · 仅供评估 · 1740096703

目录

1 研究方法与数据来源

1.1 研究方法

1.2 数据来源

1.2.1 二手信息来源

1.2.2 一手信息来源

1.3 数据交互验证

2 扇出型晶圆级封装市场概述

2.1 扇出型晶圆级封装市场概述

2.2 不同产品类型扇出型晶圆级封装分析

2.2.1 中国市场不同产品类型扇出型晶圆级封装市场规模对比（2021 VS 2025 VS 2032）

2.2.2 高密度扇出型封装

2.2.3 核心扇出型封装

2.3 不同应用，扇出型晶圆级封装主要包括如下几个方面

2.3.1 中国市场不同应用扇出型晶圆级封装规模对比（2021 VS 2025 VS 2032）

(c) 2026 APO Research. 版权所有。

2.3.2 CMOS图像传感器

2.3.3 无线连接

2.3.4 逻辑与存储集成电路

2.3.5 微机电系统和传感器

2.3.6 模拟和混合集成电路

2.3.7 其他应用

2.4 中国扇出型晶圆级封装市场规模现状及未来趋势（2021-2032）

3 中国市场扇出型晶圆级封装主要企业分析

3.1 中国市场主要企业扇出型晶圆级封装规模及市场份额

3.2 中国市场主要企业总部及主要市场区域

3.3 中国市场主要厂商进入扇出型晶圆级封装行业时间点

3.4 中国市场主要厂商扇出型晶圆级封装产品类型及应用

3.5 扇出型晶圆级封装行业集中度、竞争程度分析

3.5.1 扇出型晶圆级封装行业集中度分析：2025年中国市场Top 5厂商市场份额

3.5.2 中国市场扇出型晶圆级封装第一梯队、第二梯队和第三梯队厂商及市场份额

3.6 新增投资及市场并购活动

4 参与公司概览

4.1 台积电

4.1.1 台积电概况

4.1.2 台积电 扇出型晶圆级封装产品基准

4.1.3 台积电 扇出型晶圆级封装收入（百万元）及毛利率（2021-2026）

4.1.4 台积电主要业务

4.2 日月光半导体

4.2.1 日月光半导体概况

4.2.2 日月光半导体 扇出型晶圆级封装产品基准

4.2.3 日月光半导体 扇出型晶圆级封装收入（百万元）及毛利率（2021-2026）

4.2.4 日月光半导体主要业务

4.3 江苏长电科技

4.3.1 江苏长电科技概况

4.3.2 江苏长电科技 扇出型晶圆级封装产品基准

4.3.3 江苏长电科技 扇出型晶圆级封装收入（百万元）及毛利率（2021-2026）

4.3.4 江苏长电科技主要业务

4.4 艾克尔科技

4.4.1 艾克尔科技概况

4.4.2 艾克尔科技 扇出型晶圆级封装产品基准

4.4.3 艾克尔科技 扇出型晶圆级封装收入（百万元）及毛利率（2021-2026）

4.4.4 艾克尔科技主要业务

4.5 矽品科技

4.5.1 矽品科技概况

4.5.2 矽品科技 扇出型晶圆级封装产品基准

4.5.3 矽品科技 扇出型晶圆级封装收入（百万元）及毛利率（2021-2026）

4.5.4 矽品科技主要业务

4.6 Nepes

4.6.1 Nepes概况

4.6.2 Nepes 扇出型晶圆级封装产品基准

4.6.3 Nepes 扇出型晶圆级封装收入（百万元）及毛利率（2021-2026）

APO RESEARCH
报告样本 · 仅供评估 · 1740096703

(c) 2026 APO Research. 版权所有。

4.6.4 Nepes主要业务

5 中国扇出型晶圆级封装市场分析，按类型

5.1 中国不同类型扇出型晶圆级封装规模及市场份额（2021-2026）

5.2 中国不同类型扇出型晶圆级封装规模预测（2027-2032）

6 中国扇出型晶圆级封装市场分析，按应用

6.1 中国不同应用扇出型晶圆级封装规模及市场份额（2021-2026）

6.2 中国不同应用扇出型晶圆级封装规模预测（2027-2032）

7 动态分析

7.1 扇出型晶圆级封装行业发展机遇及主要驱动因素

7.2 扇出型晶圆级封装行业发展面临的风险

7.3 扇出型晶圆级封装行业政策分析

7.4 扇出型晶圆级封装中国企业SWOT分析

8 市场生态系统

8.1 扇出型晶圆级封装行业产业链简介

8.1.1 扇出型晶圆级封装行业供应链分析

8.1.2 主要原材料及供应情况

8.1.3 扇出型晶圆级封装行业主要下游客户

8.2 扇出型晶圆级封装行业采购模式

8.3 扇出型晶圆级封装行业开发/生产模式

8.4 扇出型晶圆级封装行业销售模式

9 研究结果

10 免责声明

APO RESEARCH
报告样本 · 仅供评估 · 1740096703

(c) 2026 APO Research. 版权所有。

图表目录

表格清单：

- 表1: 研究范围
- 表2: 中国市场不同产品类型扇出型晶圆级封装市场规模（百万元）及增长率对比（2021 VS 2025 VS 2032）
- 表3: 高密度扇出型封装主要企业列表
- 表4: 核心扇出型封装主要企业列表
- 表5: 中国市场不同应用扇出型晶圆级封装市场规模（百万元）及增长率对比（2021 VS 2025 VS 2032）
- 表6: 中国市场主要企业扇出型晶圆级封装规模（百万元）&（2021-2026）
- 表7: 中国市场主要企业扇出型晶圆级封装规模份额对比（2021-2026）
- 表8: 中国市场主要企业总部及地区分布及主要市场区域
- 表9: 中国市场主要企业进入扇出型晶圆级封装市场日期
- 表10: 中国市场主要厂商扇出型晶圆级封装产品类型及应用
- 表11: 2025年中国市场扇出型晶圆级封装主要厂商市场地位（第一梯队、第二梯队和第三梯队）
- 表12: 中国市场扇出型晶圆级封装市场投资、并购等现状分析
- 表13: 台积电 概况
- 表14: 台积电 扇出型晶圆级封装产品基准
- 表15: 台积电 扇出型晶圆级封装收入（百万元）及毛利率（2021-2026）
- 表16: 台积电主要业务
- 表17: 日月光半导体 概况
- 表18: 日月光半导体 扇出型晶圆级封装产品基准
- 表19: 日月光半导体 扇出型晶圆级封装收入（百万元）及毛利率（2021-2026）
- 表20: 日月光半导体主要业务
- 表21: 江苏长电科技 概况
- 表22: 江苏长电科技 扇出型晶圆级封装产品基准
- 表23: 江苏长电科技 扇出型晶圆级封装收入（百万元）及毛利率（2021-2026）
- 表24: 江苏长电科技主要业务
- 表25: 艾克尔科技 概况
- 表26: 艾克尔科技 扇出型晶圆级封装产品基准
- 表27: 艾克尔科技 扇出型晶圆级封装收入（百万元）及毛利率（2021-2026）
- 表28: 艾克尔科技主要业务
- 表29: 矽品科技 概况
- 表30: 矽品科技 扇出型晶圆级封装产品基准
- 表31: 矽品科技 扇出型晶圆级封装收入（百万元）及毛利率（2021-2026）
- 表32: 矽品科技主要业务
- 表33: Nepes 概况
- 表34: Nepes 扇出型晶圆级封装产品基准
- 表35: Nepes 扇出型晶圆级封装收入（百万元）及毛利率（2021-2026）
- 表36: Nepes主要业务
- 表37: 中国不同产品类型扇出型晶圆级封装规模列表（百万元）&（2021-2026）
- 表38: 中国不同产品类型扇出型晶圆级封装规模市场份额列表（2021-2026）
- 表39: 中国不同产品类型扇出型晶圆级封装规模（百万元）预测（2027-2032）
- 表40: 中国不同产品类型扇出型晶圆级封装规模市场份额预测（2027-2032）
- 表41: 中国不同应用扇出型晶圆级封装规模列表（百万元）&（2021-2026）
- 表42: 中国不同应用扇出型晶圆级封装规模市场份额列表（2021-2026）
- 表43: 中国不同应用扇出型晶圆级封装规模（百万元）预测（2027-2032）
- 表44: 中国不同应用扇出型晶圆级封装规模市场份额预测（2027-2032）
- 表45: 扇出型晶圆级封装行业发展机遇及主要驱动因素
- 表46: 扇出型晶圆级封装行业发展面临的风险
- 表47: 扇出型晶圆级封装行业政策分析
- 表48: 扇出型晶圆级封装行业供应链分析
- 表49: 扇出型晶圆级封装上游原材料和主要供应商情况
- 表50: 扇出型晶圆级封装行业主要下游客户
- 表51: 本文分析师列表

图表清单：

APO RESEARCH 报告样本 · 仅供评估 · 7140096703

(c) 2026 APO Research. 版权所有。

- 图1: 关键采访目标
- 图2: 自下而上及自上而下验证
- 图3: 资料三角测定
- 图4: 扇出型晶圆级封装产品图片
- 图5: 中国不同产品类型扇出型晶圆级封装市场份额 2025 VS 2032
- 图6: 高密度扇出型封装产品图片
- 图7: 中国高密度扇出型封装规模（百万元）及增长率（2021-2032）
- 图8: 核心扇出型封装产品图片
- 图9: 中国核心扇出型封装规模（百万元）及增长率（2021-2032）
- 图10: 中国不同应用扇出型晶圆级封装市场份额 2025 VS 2032
- 图11: CMOS图像传感器
- 图12: 无线连接
- 图13: 逻辑与存储集成电路
- 图14: 微机电系统和传感器
- 图15: 模拟和混合集成电路
- 图16: 其他应用
- 图17: 中国扇出型晶圆级封装市场规模增速预测:（2021-2032）&（百万元）
- 图18: 中国市场扇出型晶圆级封装市场规模, 2021 VS 2025 VS 2032（百万元）
- 图19: 2025年中国市场前五大厂商扇出型晶圆级封装市场份额
- 图20: 2025年中国市场扇出型晶圆级封装第一梯队、第二梯队和第三梯队企业及市场份额
- 图21: 中国不同产品类型扇出型晶圆级封装市场份额 2021 VS 2025
- 图22: 扇出型晶圆级封装中国企业SWOT分析
- 图23: 扇出型晶圆级封装产业链
- 图24: 扇出型晶圆级封装行业采购模式
- 图25: 扇出型晶圆级封装行业开发/生产模式分析
- 图26: 扇出型晶圆级封装行业销售模式分析

APO RESEARCH
报告样本 · 仅供评估 · 1740096703

(c) 2026 APO Research. 版权所有。